

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 21 年 1 月 15 日 (2009.1.15)

【公開番号】特開 2008-235842 (P2008-235842A)
 【公開日】平成 20 年 10 月 2 日 (2008.10.2)
 【年通号数】公開・登録公報 2008-039
 【出願番号】特願 2007-107585 (P2007-107585)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 23/36 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 23/36 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 20 年 9 月 5 日 (2008.9.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】手続補正書

【補正対象項目名】手続補正 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

2 つフィンを一方の面に、半導体を取り付ける面を、もう一方の面に備えたベース片に形成された突状部を他の接続するベース片に設けた対応する凹状部に圧力により次々に接続することによりベース面と複数のフィンを構成することを特徴とし、前記フィンは、前記ベース片に形成された、フィン間ピッチを 4 mm 以下にするための角度を備えた溝に、かしめられること特徴とするヒートシンク。

【請求項 2】

フィンを一方の面に、半導体を取り付ける面を、もう一方の面に備えたベース片に形成された突状部を他の接続するベース片に設けた対応する凹状部に圧力により次々に接続することによりベース面と複数のフィンを構成することを特徴とし、前記フィンは、前記ベース片に形成された、フィン間ピッチを小さくするための角度を備えた溝に、かしめられること特徴とするヒートシンク。

【請求項 3】

かしめによって接続されるフィンを一方の面に、半導体を取り付ける面を、もう一方の面に備えたベース片に形成された突状部を他の接続するベース片に設けた対応する凹状部に圧力により次々に接続することによりベース面とフィン間ピッチが 4 mm 以下の複数のフィンを構成することを特徴とするヒートシンク。

【請求項 4】

ベース面からの熱を放熱するフィンを一方の面に、半導体を取り付ける面を、もう一方の面に備えた 2 つのベース片を、接続部を介し左右に構成されたヒートシンク片に形成された突状部を他の接続するヒートシンク片に設けた対応する凹状部に圧力により次々に接続し接続後前記接続部を切断することによりベース面と複数のフィンを構成することを特徴とするヒートシンクの製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】手続補正書
【補正対象項目名】手続補正 2
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正 3】
【補正対象書類名】手続補正書
【補正対象項目名】手続補正 3
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正 4】
【補正対象書類名】手続補正書
【補正対象項目名】手続補正 4
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正 5】
【補正対象書類名】手続補正書
【補正対象項目名】手続補正 6
【補正方法】変更
【補正の内容】
【手続補正 6】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図 3
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図 3】

